



切割设备

半自动单轴六寸划片机

6110

6110 是一款高精度,高性能单轴半自动划片机,占地面积小到极致,结合全新设计的操作系统,提供高效、低使用成本的切割体验。



机器特点

- 标准配置2.2kW高转速主轴(扭矩0.42N·m,最高回转速度:60,000RPM)
- 搭载17英寸大屏幕液晶触摸屏,操作界面友好
- 0轴采用DD马达驱动,回转精度及回转分辨率高
- 碎片形状识别功能
- 可精密切割硅片、PCB板、陶瓷等,为高实用性设备,设备占地面积小,可节省运行成本

最大工作盘尺寸		Ø 150 mm
X轴	切割范围	160 mm
	进刀速度输入范围	0.1 - 600 mm/s
Y轴	切割范围	162 mm
	单步步进量	0.1 μm
	定位精度	累积精度: ≤ 4μm / 160 mm 步进精度: ≤ 2μm / 5mm
Z轴	最大行程	30 mm
	移动分辨率	0.1 μm
	重复精度	1.0 μm
θ轴	最大旋转角度	320°
	主轴类型	单主轴
主轴	额定扭矩	0.42 N·m (2.2kW)
	最高回转速度	60000 rpm
	刀片尺寸	2"
动力规格	电气	220VAC, 50 / 60 Hz, 单相电
	空气	≥200 L/min
	主轴冷却水流量	≥2 L/min(@0.3Mpa)
	切割水流量	≥5 L/min
尺寸	490 × 1100 × 1750 (mm)	
重量	约500 kg	

可浸润翼专用设备

80WT

专为可浸润侧翼工艺设计



机器特点

- 专为精密切割Wettable QFN所设计。能够在表面不平整的基板上实现切割深度的一致性以及切痕形状的一致性
- 共焦传感器
- 最多可装载4个magazines料夹,无胶带切割
- 自动装载2片QFN(也可装载单片)
- 碎屑刷

最大工作盘尺寸		12"×12" 方形
主轴		两个对向主轴(可选2.2kW)最高60000转
刀片尺寸		2"~3"
Y1 / Y2 轴	控制器	线性编码器/Y轴
	分辨率	0.1 μm
	累积精度	1.5 μm
	步进精度	1.0 μm
X轴	切割范围	350 mm
	X轴	气动滑块
Z1 / Z2 轴	分辨率	0.2 μm
	重复精度	1.0 μm
	最大行程	50 mm (2.188" 刀片外径)
θ轴	重复精度	4 arc-sec
	行程	380°
清洗台	完全冲洗和干燥循环	
	旋转速度	100 - 3000 rpm
电气	二流体清洗功能	
	电气	200-240VAC, 50/60 Hz, 单相电
尺寸	1145×1687×1830 (mm)	
重量	1500kg	